

高熱伝導AINファイラー FAN-fシリーズ

高熱伝導率をもつAIN微粉末に少量の焼結助剤Y2O3と粒度制御剤BNを加え高温焼結して得られたAINファイラーは、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、BTレジンなど各種樹脂に対して充填性、流動性に優れ、高放熱性を実現します。

特性

※代表値

Grade	FAN-f05	FAN-f30-A1	FAN-f50-A1	FAN-f80-A1
成分	AIN (少量添加物Y2O3 , BN)			
粒子形状	多面体粒	球状		
熱伝導率 W/m·K(RT)	170 (焼結体)			
絶縁抵抗 Ω·cm(RT)	>10 ¹³ (焼結体)			
密度 g/cm ³	3.3 (焼結体)			
平均粒径 μm	3~10	20~40	35~65	65~90
D10	3	15	20	30
D90	8	50	95	150
備考	一次粒子径	<200mesh		

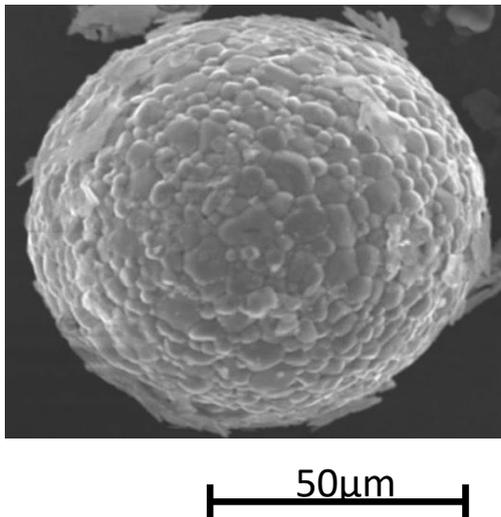
特長

- ・絶縁 & 高熱伝導
- ・球状粒子
- ・高充填率

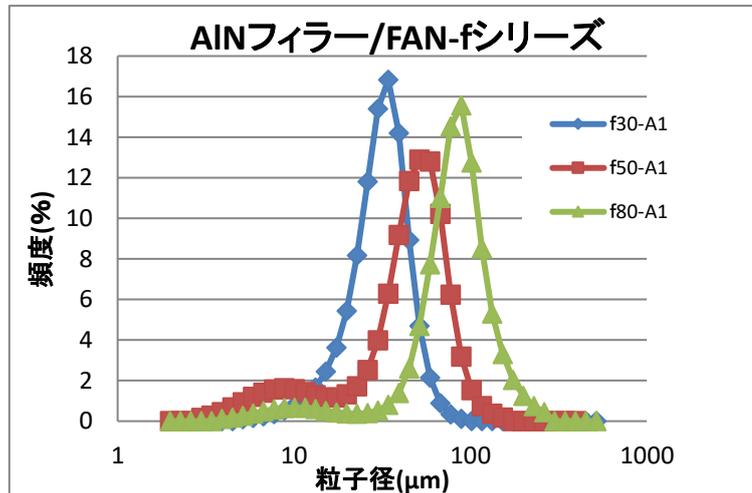
用途

- ・半導体封止用樹脂
- ・放熱シート
- ・放熱基板

粒子形状(例: FAN-f80-A1)



粒度分布例



古河電子株式会社

営業部 営業課

〒100-8370 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

E-mail: densi-s@furukawakk.co.jp